公司代码:688072 公司简称:拓荆科技

拓荆科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为126,478,797股,以此计算合计拟派发现金红利32,884,487.22元(含税)。本年度公司现金分红在本期归属于上市公司股东的净利润比例为8.92%,占本期实现的可供分配利润的比例为10.26%。本次利润分配方案不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,公司独立董事已对上述利润分配方案发表了同意的独立意见。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	拓荆科技	688072	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵曦	刘雅婷
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区水家900号	辽宁省沈阳市浑南区水家900号
电话	024-24188000-8089	024-24188000-8089
电子信箱	Dongban@piotech.cn	ir@piotech.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

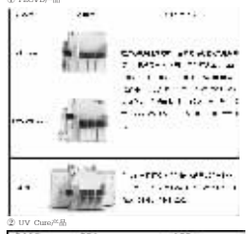
公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成立以来,公司始终坚持自主研发,目前已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD等薄膜设备产品系列,该产品系列已广泛应用于国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线。同时,公司不发了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备产品系列。

2、主要产品情况

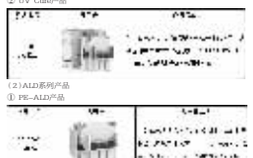
报告期内,公司不断完善现有量产薄膜设备系列产品性能,保持产品核心竞争力,进一步提升量产产品的市场占有率。同时,持续丰富公司产品品类,拓展工艺应用领域。公司PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD及键合系列产品情况如下:

(1)PECVD系列产品

① PECVD产品

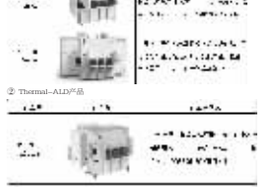


② UV Cure产品

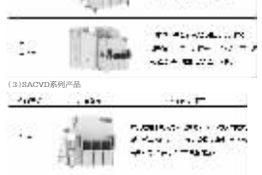


(2)ALD系列产品

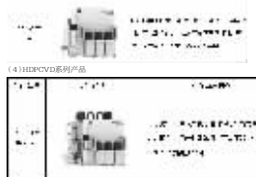
① PE-ALD产品



② Thermal-ALD产品



(3)SACVD系列产品



(4)HDPCVD系列产品

(5)混合键合系列产品

① 晶圆对晶圆键合产品

产品型号	产品应用情况
Dione 300	主要应用于晶圆级三维集成芯片制造领域,正在进行产业化验证,可实现12寸晶圆对晶圆的混合键合和熔融键合。

② 芯片对晶圆键合表面预处理产品

产品型号	产品应用情况
Pollux	主要应用于晶圆级三维集成芯片制造领域,正在进行产业化验证,主要应用于晶圆及切割后芯片的表面活化及清洗。

注:随着公司产品种类的不断丰富,公司持续完善产品型号命名规则。报告期内,经履行公司内部决策程序,对公司产品型号名称进行调整,结合设备平台类型及反应腔类别重新命名产品型号。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二) 主要经营模式

(1)盈利模式

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务。公司通过向下游客户销售薄膜沉积设备并提供备品备件和技术服务来实现收入和利润。报告期内,公司主营业务收入来源于半导体设备的销售,其他业务收入主要来源于设备有关的备品备件销售。

(2)研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司建成了一支国际化、专业化的半导体薄膜沉积设备研发技术团队。公司的研发技术团队结构合理,分工明确,专业知识储备深厚,产线验证经验丰富,是公司自主研发能力的基石。公司根据客户需求,半导体专用设备技术发展动态为导向,研发设计新产品、新工艺、研制机台、调试性能参数,在通过公司测试之后,送至客户实际生产环境中进行产业化验证,通过验证后产品正式定型,此外,公司会根据客户不同的工艺用需求,持续丰富、完善量产产品性能。

(3)采购模式

公司采购主要分为标准件采购和非标件采购。对于标准件采购,公司面向市场供应商进行直接采购。非标件主要为公司研发生产中,根据特定技术需求,自行设计的零部件。对于非标件采购,公司主要通过向供应商提供设计图纸,明确参数要求,由供应商自行采购原材料进行加工并完成定制;针对特定零部件,公司存在提供图纸及参数,在通过公司测试之后,送至客户实际生产环境中进行产业化验证,通过验证后产品正式定型。此外,公司会根据客户不同的工艺用需求,持续丰富、完善量产产品性能。

(4)生产模式

公司的产品主要根据客户的差异化需求和采购意向,进行定制化设计及生产制造,公司主要采用库存式生产和订单式生产相结合的生产模式。库存式生产,指公司尚未获取正式订单便开始生产,包括根据Demo订单或较明确的客户采购意向启动的生产活动,适用于公司的Demo机台和部分销售机台。订单式生产,指公司与客户签署正式订单后进行生产,适用于公司大部分的销售机台。

(5)销售和服务模式

报告期内,公司销售模式为直销,通过与潜在客户商务谈判,招投标等方式获取客户订单。经过多年的努力,公司已与国内半导体行业业部成了较为稳定的合作关系。

公司的销售模式一般包括市场调查与推介、获取客户需求及公司内部讨论、产品报价、投标操作与管理(如适用)、销售协议、合同评审、销售订单(或Demo订单)签订与执行、产品安装调试、合同回款、客户验收及售后服务等步骤。公司的设备发运至客户新址地点后,需要客户的生产线上进行安装调试,通常客户在完成机台测试后,对设备进行验收,公司在客户验收完成后确认收入。

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段、基本特点

①半导体设备行业

半导体行业的发展水平与国家科技水平息息相关,其发展情况已成为全球各国经济、社会发展的风向标,是衡量一个国家现代化程度和科技实力的重要标志。半导体设备作为半导体产业链的技术与动力,是半导体产业发展的基础和技术进步的源动力。随着半导体技术的迭代升级,半导体元器件逐步向精密化、微小化发展,对制造工艺技术不断提出挑战,半导体设备的重要地位日趋凸显。

纵观半导体行业的发展历史,呈现明显的周期性波动,主要由于行业技术迭代、下游应用创新驱动、终端应用的需求等因素叠加全球经济波动所致,从全球范围来看,2020年以来,受到全球消费电子、汽车电子等下游供应链缺installed,全球半导体市场需求爆发,行业景气度上升,半导体设备行业保持高速增长态势。根据SEMI数据统计,2022年度,受行业景气度转换的影响,全球半导体制造设备的销售额较上年同期实现小幅增长,达到107亿美元,从中国大陆市场来看,2022年中国大陆半导体设备销售额为203亿美元,连续第三年成为全球最大半导体设备市场。

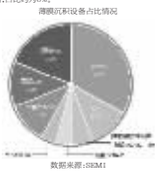
目前全球半导体设备市场主要由国际厂商主导。伴随着我国对半导体产业不断的政策扶持、加大投入力度,加速了国内半导体设备产业的发展和市场,并迎来了巨大的成长机遇。

②薄膜沉积设备行业

半导体产业的发展衍生出巨大的半导体设备市场,而应用于集成电路领域的设备通常可分为前道工艺设备(晶圆制造)和后道工艺设备(封装测试)两大类。其中,晶圆制造设备的市场规模约占总设备市场规模的80%,而薄膜沉积设备则是集成电路前道生产工艺中的三大核心设备之一。2022年全球薄膜沉积设备市场规模约为229亿美元,同比2021年实现小幅增长,而中国大陆市场也保持增长趋势,具有广阔的市场空间。

薄膜沉积设备主要包括CVD设备和PVD设备。公司主要聚焦在CVD设备细分领域内的PECVD、ALD、SACVD及HDPCVD。不同种类的薄膜沉积设备适用于不同工艺制程对膜质量、厚度以及孔隙内精密充填力等不同要求。在2021年全球各类薄膜沉积设备市场份额中,PECVD是薄膜设备中占比最高的设备类型,占整体薄膜沉积设备市场的33%,ALD设备占比约为11%,SACVD和HDPCVD属于其他薄膜沉积设备类目下的产品,占比约为6%。

薄膜沉积设备占比情况



数据来源:SEMI

③三维集成领域设备行业

三维集成领域设备是三维集成芯片(Chiplet等芯片先进架构设计的技术基础。混合键合设备作为代表的三维集成专用设备尚处于产品导入期,业界目前已经在存储器、图像传感器和逻辑芯片领域初步实现产业化。随着“后摩尔时代”的来临,三维集成领域将进入成长期,混合键合设备作为关键设备,其细分市场届时也将迎来剧烈增长。

(2)主要技术门槛

半导体设备行业属于技术密集型行业,涉及化学、等离子体物理、流体力学、射频及微波学、电气控制及自动化、软件工程、机械工程等多种科学技术及工程领域学科知识的综合应用,具有技术壁垒高、产品验证周期长的特点。

①薄膜沉积技术

半导体行业通常是“一代产品、一代工艺、一代设备”,晶圆制造要超前下游应用开发新一代工艺,而半导体设备要超前晶圆制造开发新一代设备。薄膜沉积设备作为集成电路晶圆制造的核心设备,其技术的发展支撑了集成电路制造工艺的发展,跟随摩尔定律的节奏,每隔18-24个月便要推出更先进的制造工艺,不断追求技术革新。

在薄膜沉积设备研制过程中,其反应腔设计、腔体内关键传设计、气路设计、温度控制及射频控制需要在基础理论知识深刻理解外,结合整机设计思路和产线工艺理解,技术壁垒较高。此外,集成电路制造不同技术路线及不同工序需要的薄膜材料种类不同,薄膜沉积设备需要针对不同材料本身的物理、化学性质,进行工艺开发,以实现不同材料的沉积功能。

由于薄膜是芯片结构的功能材料层,在芯片完成制造、封测等工序后一般会留存在芯片中,薄膜的技术参数直接影响芯片性能。生产中不仅需要在成膜后检测薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标,还需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后,对故障芯片产品进行可靠性和生命周期测试,以衡量薄膜沉积设备是否能够满足技术标准。因此,薄膜沉积设备所需要的验证时间较长。

随着集成电路制造产线向更小线宽发展,芯片内部立体结构日趋复杂,所需要的薄膜沉积数量越多,对绝缘介质薄膜、导电金属薄膜的材料种类和性能参数要求不断提出新的要求,因此,技术门槛也在日益提升。

②混合键合技术

由于“后摩尔时代”集成电路制程无法持续向更小线宽发展,键合设备将持续推动芯片性能的提高和行业的发展。键合设备提供的关键指标是键合面的质量,包括对准精度、键合强度以及界面空洞率,其中对准精度影响芯片性能,键合强度影响芯片性能,键合强度影响芯片良率。键合设备的研制,对于高精密对准系统、微纳精密机械控制、图像处理和分析、亚纳米级等技术需要具深刻的理解和产业化实践经验,技术壁垒较高。随着“后摩尔时代”的来临,业界会对于键合设备性能将提出更高的要求。

2. 公司所处的行业地位分析及其优劣情况

从全球市场份额来看,薄膜沉积设备行业呈现出垄断竞争的格局,行业基本由应用材料(AMAT),先晶半导体(Lam),东京电子(TEL)等国际巨头垄断,在CVD市场中,应用材料(AMAT)、泛林半导体(Lam)和东京电子(TEL)三大厂商占据了全球约70%的市场份额。在晶圆级三维集成领域,键合设备市场主要由EV Group公司、苏斯(SUSS)等公司高度垄断,占据全球超70%的市场份额。

公司凭借十多年的技术积累,自主研制了包括PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD等薄膜设备系列产品,在国内主要集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线有广泛应用。同时,面向前沿技术需求,公司开发了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备系列产品。目前薄膜系列产品在客户产线实现量产的设备性能指标已达到国际同类设备先进水平。公司目前是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备、HDPCVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。虽然公司产品的制程规模在稳步提升,但整体市场占有率与国际巨头尚有差距。

3. 报告期内新技术、新产业、新模式的发展情况和未来发展趋势

①半导体设备市场需求稳步增长

疫情半导体行业的发展历史,虽然行业呈现明显的周期性波动,但整体增长趋势并未发生变化,而每一次技术变革是驱动行业持续增长的主要动力。在人工智能、电动汽车、新能源等新兴领域的快速发展拉动下,晶圆厂将持续进行资本开支,扩充产能,进而带动半导体设备的市场需求量。薄膜沉积设备作为集成电路晶圆制造的核心设备,具有巨大的市场需求和增长空间。

根据SEMI预测报告,在2022年至2026年期间,下游芯片制造厂商将持续扩充产能,以满足需求增长,目前最新更新的366座厂房和产线中,288座在运营,108座计划在未来启建。根据集微咨询统计,中国大陆预计未来5年(2022年至2026年)还将新增26座12英寸晶圆厂,总规划月产能超过160万片。截至2026年底,中国大陆12英寸晶圆厂的总月产能将超过27%3万片。未上晶圆厂的总月产能将超过27%3万片。

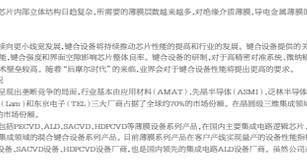
②芯片制造工艺进步及结构复杂化提高薄膜设备需求

在90nm、CMOS芯片工艺中,大约需要30道薄膜沉积工序。在FinFET工艺产线,大约需要超过100道薄膜沉积工序,涉及的薄膜材料由6种增加到近20种,对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级,进而拉动晶圆厂对薄膜沉积设备需求量的增加。

不同工艺节点薄膜沉积工序对比

在FLASH存储芯片领域,随着主流制造工艺已由2D NAND发展为3D NAND结构,结构的复杂化导致对于薄膜沉积设备的需求量逐步增加。而随着3D NAND FLASH芯片的堆叠层数不断增高,从32/64层逐步向更多层及更先进工艺发展,对于薄膜沉积设备的需求提升的趋势亦将延续。

2D NAND与3D NAND结构简图



资料来源:SEMI,广发证券

在芯片工艺技术持续进步的趋势下,当晶以通过光刻直接形成先进工艺的情况下,可以结合薄膜沉积设备(主要为ALD设备)与刻蚀设备相配合,采用自对准多重成象技术,实现更小尺寸的工艺,这将进一步促进ALD设备及相关设备的重要性及需求量的提升。

③先进制程对薄膜沉积设备提出更高要求

在晶圆制造过程中,薄膜起到产生导电层或绝缘层,阻挡污染物和杂质渗透,提高吸光率,调控阻挡刻蚀等重要作用。随着芯片制造工艺不断走向精密化,对薄膜工艺性能提出了更高的技术要求,包括薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标,市场对于高性能薄膜设备的依赖逐渐增加,这也将拉动半导体高端薄膜设备的需求。

④“后摩尔时代”产生新的设备需求

三维集成领域通过芯片叠加的形式,使单位面积内的晶体管数量增加从而提高芯片整体性能,是一种市场趋势的必然。由于摩尔定律的经济效益降低和物理极限的存在,业界不能再只依赖缩短工艺程序去实现芯片性能和复杂度的指数型提升,因此三维集成为代表的先进芯片架构是一种必然趋势。

键合设备作为全球半导体业界带来芯片模块间先进的通信速度,未来广泛应用于三维集成领域。业界的连接点间距缩短是行业的趋势,从引线键合采用的侧装设计(pitch≈1mm级别),再到引凸板(pitch≈100um级别),硅中介板(pitch≈10um级别),最终到晶合键合(pitch≈1um级别)。而其中的技术趋势就是连接点的间距代表的芯片模块间通信速度不断提升,因此混合键合在保障芯片模块间通信速度方面是目前全球最先进的产业化方案之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	7,313,286,512.91	2,517,728,208.91	190.47	1,814,069,093.40
归属于上市公司股东的净资产	3,711,530,962.28	1,192,607,668.60	211.21	1,122,209,674.37
营业收入	1,705,562,723.82	757,960,880.13	125.02	435,627,676.17
归属于上市公司股东的净利润	368,517,560.14	68,486,475.03	438.09	-11,489,015.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,104,100.53	-82,001,875.37	-	-57,116,203.25
经营活动产生的现金流量净额	247,625,867.82	137,480,579.51	80.12	308,912,704.99
加权平均净资产收益率(%)	13.13	5.92	增加7.21个百分点	-1.11
基本每股收益(元/股)	3.18	0.72	341.67	不适用
稀释每股收益(元/股)	3.17	0.72	340.28	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	22.21	38.04	减少15.83个百分点	28.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	107,517,692.90	415,699,178.00	468,306,876.31	714,038,976.61
归属于上市公司股东的净利润	-11,878,144.75	120,000,836.87	129,370,235.32	131,024,622.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,658,876.22	70,809,162.99	62,624,489.57	66,329,334.19
经营活动产生的现金流量净额	69,512,007.12	191,829,634.38	-278,955,611.77	365,239,838.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,064
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,763
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	25,121,755	19.86	25,121,755	25,121,755	无	0	国有法人
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	0	17,297,297	13.68	17,297,297	17,297,297	无	0	其他
中微半导体设备(上海)股份有限公司	0	10,622,547	8.40	10,622,547	10,622,547	无	0	境内非国有法人
上海鼎芯投资管理有限公司-嘉兴启隐投资合伙企业(有限合伙)	0	7,012,105	5.54	7,012,105	7,012,105	无	0	其他
中合盛资本管理有限公司-青岛润势嘉禾投资合伙企业(有限合伙)	0	6,233,158	4.93	6,233,158	6,233,158	冻结	6,233,158	其他
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	0	3,000,000	2.37	3,000,000	3,000,000	无	0	国有法人
拓荆科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	-230,000	2,970,297	2.35	2,970,297	2,970,297	无	0	其他
招商证券资管-招商银行-招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,624,674	2,624,674	2.08	2,624,674	3,080,974	无	0	境内非国有法人
苏州聚源东方投资基金中心(有限合伙)	0	1,800,180	1.42	1,800,180	1,800,180	无	0	其他
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司-中车国信(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,621,622	1.28	1,621,622	1,621,622	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与股权激励对象之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司产品持续保持较强竞争优势,同时受益于国内主要晶圆厂半导体设备需求增加以及国家政策对国产设备的大力支持,公司产品销量同比大幅增加,实现营业收入170,566.27万元,较上年同期增长125.02%,营业收入大幅增长;实现归属于上市公司股东的净利润368,517,560.14元,较上年同期增长438.09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润178,104,100.53元,较上年同期增加26,010.60万元实现扭亏为盈,盈利能力持续增强。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2023-016

拓荆科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2023年度审计机构。该议案尚需经公司2022年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	235人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年(经审计)业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	468	

2.投资者保护能力

截至2022年末,天健已累计计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的x%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
创新科技人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚10次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚14人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及30人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈政鑫	2006年	2004年	2006年	2019年	近三年签署了传化智联、兆丰股份、国盛智科等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	陈政鑫	2006年	2004年	2006年	2019年	近三年签署了传化智联、兆丰股份、国盛智科等上市公司年度审计报告
	吴珊珊	2015年	2012年	2015年	2019年	近三年未签署其他上市公司审计报告
项目质量控制复核人	高燕平	2010年	2010年	2011年	2021年	近三年签署了苏豫农发、苏美达等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

2、审计收费

公司2022年度的审计费用为人民币100万元,其中时务报告审计费用80万元,内部控制审计费用20万元。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司于2023年4月13日召开第一届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。审计委员会对天健年度审计工作情况及其执业质量进行了全面客观评价,认为:天健在对本公司2022年度财务报告审计过程中,经过与公司管理层的充分沟通,制订了合理的审计计划,密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络,参与审计的合计样严格遵循中国注册会计师独立审计准则的规定,履行了必要的审计程序,向公司出具了标准无保留意见的审计报告。出具的审计报告能够充分反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量,审计结论符合公司的实际情况。审计委员会同意继续聘任天健为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并将本议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

1.独立董事事前认可意见

天健具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为公司提供了优质的审计服务,其在担任公司审计机构期间勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见,为保证公司审计工作的延续性,全体独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

2.独立董事独立意见

经核查,独立董事认为:天健具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为公司提供了优质的审计服务,其在担任公司审计机构期间勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见,为保证公司审计工作的延续性,全体独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月14日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》,董事会认为,天健具有良好的专业素质和职业道德,能够为公司提供优质的审计服务,因此,全体董事一致同意继续聘任天健为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并将本议案提交至公司2022年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2023-015

拓荆科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度利润分配方案为:每10股派发现金红利2.60元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●公司2022年度拟分配的现金红利总额为2022年度归属于上市公司股东净利润之比低于30%,主要是对目前公司所处的行业特点及发展阶段,结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑,公司提出此次利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币368,517,560.14元,提取法定盈余公积后,公司2022年度可供分配利润为人民币320,573,759.07元。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为126,478,797股,以此计算合计拟派发现金红利32,884,487.22元(含税)。本年度公司现金分红在本期归属于上市公司股东的净利润比例为8.92%,占本年度实现的可供分配利润的比例为10.26%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2022年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润368,517,560.14元,公司拟分配的现金红利总额为32,884,487.22元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、制造和技术服务,半导体设备的研制涉及众多专业学科,具有较高的技术壁垒及较长的验证周期。为了保持产品竞争力,需持续投入大量资金进行研发。随着芯片工艺及结构趋于复杂化,对半导体设备需求更加精密化、多样化,半导体设备厂商需要持续进行研发投入,持续优化产品成熟出新产品,以满足芯片的性能需求。因此,公司的需要投入大量资金以推动研发创新和产品迭代升级。

未来,公司将继续在高端半导体设备领域深耕,持续丰富产品种类,扩宽应用领域,提升公司的核心竞争力,紧跟国内市场机遇和行业发展方向,提升公司收入和利润规模,维护好公司价值,为股东和投资者创造更多回报。

(二)上市公司盈利水平及资金需求

公司2022年度实现营业收入1,705,562,723.82元,同比增长125.02%,实现归属于上市公司股东的净利润368,517,560.14元,同比增长438.09%,公司增长能力和盈利能力不断增强。同时,公司由于快速发展仍然需要大量的资金支持,未来,公司在研发投入、产能扩张、业务拓展、人才招聘及日常经营等方面资金需求仍然巨大。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

在充分考虑公司当前发展状况、发展战略以及重大资金支出安排等因素,并结合《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中现金分红政策,公司提出上述2022年度利润分配方案,既保护广大投资者的合法权益,又满足推动公司各项战略规划落地,保证公司持续、稳定、健康发展的需求。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度,用于加大研发投入,加强生产经营发展,以提升公司核心竞争力,提高产品竞争力,进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决